

# 半导体金属封装外壳 安徽步微 合肥金属封装外壳

产品名称	半导体金属封装外壳 安徽步微 合肥金属封装外壳
公司名称	安徽步微电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县义井乡 合淮路1幢119室
联系电话	18756088865 18756088865

## 产品详情

选取材料的，合肥金属封装外壳，生产设备的环境控制和制作工艺对绝缘电阻也有影响，如果原材料的纯度，陶瓷/玻璃表面的多孔性，烧结温度太低/太高，金属边缘的扩散形变膨胀，装配不合规范，to金属封装外壳，尺寸公差过大都会受到影响。光纤类管壳/金属封装类外壳对绝缘性能有较高的要求，其内部结构的特殊性，侧面内壁与底部均有金属化区域，因此要从设计，工艺上予以保证。

金属封装中Cu基复合材料的结构是什么样的？其中有什么隐含的问题。

铜-金刚石复合材料被称之为Dymalloy。这种复合材料具备很好的热物理性能和机械性能，试验表明金刚石的体积分数为55%左右时，在25-200 的热导率为600W(m-1K-1)左右，比铜还要高，而它的CTE为 $5.48 \times 10^{-6} - 6.5 \times 10^{-6} K^{-1}$ ，可与Si、GaAs的CTE相匹配。这种材料已由美国Lawrence Livermore国家实验室与Sun Microsystems公司开发作为多芯片模块(MCM)的基板使用。2002年6月日本Somitomo Electric Industries(SEI)公司也开发出铜—金刚石复合材料，取名为Diamond-Metal-Composite for Heat Sink(DMCH)。

### 经济性

经济性是选择检漏方法的关键之一。单考虑检漏方法本身的经济性比较容易，但要从所需的检漏设备、对人员的技术要求、检漏结果的可靠性等方面综合评价检漏方法的经济性则较困难。

### 一致性

对有些检漏方法来说，不管检测人员是否熟练，所得到的检测结果都基本相同;有些方法则是内行和外行使用，其结果全然不同。可能的情况下，应采用不需要熟练的专门技术就能正确检测的方法。每种方法都有不同的技术关键，不同的检漏人员未必能得出一致的检漏结果

可靠性 未检测出泄漏并不等于就是没有泄漏，对此应进行判断。采用某种方法进行检漏时，应该了解该方法是否可靠。检漏结果的可靠性与上面介绍的方法的一致性、稳定性等多种因素有关。

半导体金属封装外壳-安徽步微(在线咨询)-合肥金属封装外壳由安徽步微电子科技有限公司提供。安徽步微电子科技有限公司(www.ahbuwei.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的五金模具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽步微和您携手步入辉煌，共创美好未来！